

半導体パッケージとその材料の技術マーケティング

パナソニックインダストリー株式会社での募集です。 事業企画・事業開発のご経験の...

Job Information

Recruiter
JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company
パナソニックインダストリー株式会社

Job ID
1610915

Industry
Electronics, Semiconductor

Job Type
Permanent Full-time

Location
Tokyo - 23 Wards

Salary
5 million yen ~ 10 million yen

Work Hours
08:30 ~ 17:00

Holidays
【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 入社7ヶ月目には最低10日以上 【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 GW 夏季...

Refreshed
October 30th, 2026 21:00

General Requirements

Career Level
Mid Career

Minimum English Level
Business Level

Minimum Japanese Level
Native Level

Minimum Education Level
Bachelor's Degree

Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2372863】
●担当業務と役割
電子材料の新商品企画及び技術開発を牽引し、市場投入のために関連部門と連携のうえ、総合的な戦略を立案～顧客（主にグローバル半導体メーカー）開発と折衝を行います。
・先端半導体パッケージ市場の10年先の変化を先読みし、開発ロードマップを策定と市場戦略の立案と実行
・材料レイヤーよりも上位の基板、実装プロセスなどの知見を用いた、顧客開発と材料開発、技術マーケティング活動
・顧客ニーズやトレンド分析に基づき、新商品のターゲットスペックや商品戦略策定
・開発・技術部門との連携による商品具現化、顧客との折衝、開発・販売戦略をグローバルに展開

●具体的な仕事内容
将来の有線系半導体デバイス、無線系半導体デバイスの進化・必要要件を調査し、そのパッケージ技術進化予測をもって、材料開発のテーマ化、開発部門連携の上 顧客折衝を行う。
・入社後に担当頂くアプリケーション分野を決定し、その分野の半導体デバイスのパッケージ形態を技術マーケティング、顧客との直接折衝を担当します。FAE業務も含みます。

●魅力
・AI開発が社会の進化をリードしている昨今、その進化を支える先端半導体パッケージ技術分野において、最先端の半導体技術を手掛けるグローバル企業とビジネスを通じてコネクト出来ます。
・世界の半導体市場を牽引するのマーケットリーダーとの直接対話を通じて、世界を変えるような新商品の創出に挑戦する事が出来ます。
・電子材料レイヤー視点から、地域、業界、市場といった広い視野を持って戦略を立案するなど、マーケターとしての自己成長の機会を得られます。

●キャリアパス
・半導体パッケージのマーケターとしてグローバルに自立
・本人の希望も踏まえ、海外拠点でのマーケティングおよび責任者としての赴任可能性
・力量を踏まえ、マーケティング上位職への登用も検討

Required Skills

以下、メンバー ~ 管理職候補クラス共通です

【必須】
・半導体パッケージの開発経験を5年以上お持ちの方 (有機サブストレート基板開発、後工程の実装技術開発など)
・半導体パッケージ市場/ICメーカーとの対話力、新市場開拓、新商品開発の企画力をお持ちの方
・FAE (Field Application Engineering)、かつ商品認定活動経験をお持ちの方
・英語によるビジネスコミュニケーション
【歓迎】
・サブストレート基板、およびそのプロセスを熟知している方
・半導体パッケージ後工程の実装技術やプロセス知識、業界用語、サプライチェーンを熟知している方

Company Description

電気部品・電子部品・制御機器・電子材料等の開発・製造・販売